

## 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

经成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公司于2021年6月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司上述对子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

### 二、保证合同的主要内容

近日，公司（以下称“保证人”）与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签署完成编号为0440200055-2021年高新（保）字0031号（担保金额5,000万元）的《保证合同》，主要内容如下：

- 1、保证的方式：连带责任保证。
- 2、被担保的主债权：期限为1年的合计不超过5,000万元人民币的流动资金贷款。
- 3、保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起三年。

公司具体担保的权利义务以与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产

业开发区支行签署的《保证合同》为准。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2020 年度经审计归属于上市公司净资产的 4.93%。截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 7,300 万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为 12,300 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司净资产的 12.14%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 四、备查文件

- 1、成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议。
- 2、与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签署的《保证合同》。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日